仅供内部参考，请勿外传！





强于大市

# 模型降价端侧放量，制造链景气上行明确

*TMT 行业周报*

**本周海外大模型同步上新降价，模型价格竞争日益激烈，端侧应用门槛降低，端侧算力芯片渗透率大幅提升，AIoT 需求持续攀升，下半年起端侧芯片迎新品周期，盈利成长确定性高；模型类公司亦受益于调用成本下降加速渗透。制造端，台积电拟于 2027 年起调涨代工价格，目前晶圆代工与先进封测产能全面吃紧，扩产提速带动设备、零部件、材料供不应求。**

## 支撑评级的要点

- **模型降价打开应用门槛，端侧 AI 进入放量通道。**近期海外大模型公司同步上新降价：9 月 23 日，Anthropic 发布 Claude 5.5 系列首款模型 Claude Opus 5.5，称其在大多数工作上表现可媲美 Claude Fable 5.1，运行成本比 Opus 5 低 40%。OpenAI 同日推出 GPT-6 Sol 与 GPT-6 Luna，API 价格较上代接近砍半，模型竞争正式进入“单位成本最优”的价格战阶段。模型降价直接摊薄了终端智能化的边际成本，端侧应用的普及门槛显著降低。从产业节奏看，今年下半年至明年上半年端侧芯片将迎来密集的新品发布周期，新平台在 NPU 算力、功耗与成本上的迭代将进一步打开端侧 AI 的场景空间，端侧芯片厂商盈利成长的确定性较高。与此同时，模型降价也利好 AI 模型类公司的加速渗透：调用成本下降推动大模型从示范场景走向规模化商用，头部模型厂商及垂直行业模型公司的商业化兑现节奏有望加快。
- **AI 需求拉动制造景气。**AI 需求的持续释放正带动半导体景气度逐环节抬升。本周据 Digitimes 报道，台积电拟于 2027 年 1 月起按制程上调晶圆代工价格 3%—6%，其中 2 纳米、3 纳米等先进制程涨幅较高——目前台积电 8 英寸厂产能利用率超过 100%、45 纳米以下制程满载，订单能见度已延伸至 2030 年。成熟制程同样供不应求：联电预告将启动涨价，力积电传出报价要大幅上调四成，背后是 AI 基础设施拉动电源管理 IC、MCU、功率器件等配套芯片需求，叠加台积电收缩成熟制程产能的订单外溢效应。封测端，先进封装产能持续吃紧，部分封测设备交期已拉长至一年以上。产能紧张倒逼晶圆厂与封测厂加快扩产节奏，设备、零部件、材料环节进入供不应求的紧俏周期，国产替代与扩产浪潮共振，半导体制造链景气上行趋势明确。
- **AI 景气自上而下传导，看好端侧芯片与半导体制造双主线。**我们认为，当前 AI 产业的投资线索正沿着“模型降价→应用放量→芯片需求→制造扩产”的链条自上而下传导，景气验证不断下沉：模型端价格战降低应用门槛，端侧与 AIoT 场景加速打开；芯片端新品周期临近，渗透率与单机价值量双升；制造端代工、封测产能全面吃紧，涨价与扩产共振，设备、零部件、材料的订单能见度持续拉长。

## 投资建议

- 建议关注三方面：**【端侧算力芯片】**把握下半年至明年上半年的新品周期与盈利成长确定性，建议关注**瑞芯微、星宸科技、晶晨股份、全志科技、恒玄科技**等；**【AI 模型及应用】**受益于调用成本下降后的加速渗透，建议关注**智谱、MiniMax、中控技术、卓易信息**等；**【半导体制造链】**继续看好本轮 AI 带动的制造机遇，建议关注**中芯国际、华虹宏力、长鑫科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、长川科技、富创精密、富乐德、中科仪**。

## 评级面临的主要风险

- CSP 厂商资本开支落地不及预期，FDE 交付成本较高、标准化和规模化能力不足，B 端 AI 需求不及预期。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

计算机

证券分析师：苏凌瑶
lingyao.su@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300522080003

证券分析师：郑静文
jingwen.zheng@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300525010001

仅供内部参考，请勿外传！



# 目录

**“一周解码”——本周重点关注事件 ..... 4**

模型降价端侧放量，制造链景气上行明确 ..... 4

**新闻及公司动态 ..... 5**

行业新闻 ..... 5

公司动态 ..... 6

**风险提示 ..... 8**

仅供内部参考，请勿外传！



# 图表目录

图表 1.芯片及服务器-行业动态 ..... 5
图表 2.云计算-行业动态 ..... 5
图表 3.人工智能-行业动态 ..... 5
图表 4.数字经济-行业动态 ..... 6
图表 5.网络安全-行业动态 ..... 6
图表 6.工业互联网-行业动态 ..... 6

仅供内部参考，请勿外传！



## “一周解码”——本周重点关注事件

### 模型降价端侧放量，制造链景气上行明确

**模型降价打开应用门槛，端侧 AI 进入放量通道。**近期海外大模型公司同步上新降价：9 月 23 日，Anthropic 发布 Claude 5.5 系列首款模型 Claude Opus 5.5，典型任务运行成本较上代下降 40%；OpenAI 同日推出 GPT-6 Sol 与 GPT-6 Luna，API 价格较上代接近砍半，模型竞争正式进入“单位成本最优”的价格战阶段。模型降价直接摊薄了终端智能化的边际成本，端侧应用的普及门槛显著降低。从产业节奏看，今年下半年至明年上半年端侧芯片将迎来密集的新品发布周期，新平台在 NPU 算力、功耗与成本上的迭代将进一步打开端侧 AI 的场景空间，端侧芯片厂商盈利成长的确定性较高。与此同时，模型降价也利好 AI 模型类公司的加速渗透：调用成本下降推动大模型从示范场景走向规模化商用，头部模型厂商及垂直行业模型公司的商业化兑现节奏有望加快。

**AI 需求拉动制造景气。**AI 需求的持续释放正带动半导体景气度逐环节抬升。本周据 Digitimes 报道，台积电拟于 2027 年 1 月起按制程上调晶圆代工价格 3%—6%，其中 2 纳米、3 纳米等先进制程涨幅较高——目前台积电 8 英寸厂产能利用率超过 100%、45 纳米以下制程满载，订单能见度已延伸至 2030 年。成熟制程同样供不应求：联电预告将启动涨价，力积电传出报价要大幅上调四成，背后是 AI 基础设施拉动电源管理 IC、MCU、功率器件等配套芯片需求，叠加台积电收缩成熟制程产能的订单外溢效应。封测端，先进封装产能持续吃紧，部分封测设备交期已拉长至一年以上。产能紧张倒逼晶圆厂与封测厂加快扩产节奏，设备、零部件、材料环节进入供不应求的紧俏周期，国产替代与扩产浪潮共振，半导体制造链景气上行趋势明确。

**AI 景气自上而下传导，看好端侧芯片与半导体制造双主线。**我们认为，当前 AI 产业的投资线索正沿着“模型降价→应用放量→芯片需求→制造扩产”的链条自上而下传导，景气验证不断下沉：模型端价格战降低应用门槛，端侧与 AIoT 场景加速打开；芯片端新品周期临近，渗透率与单机价值量双升；制造端代工、封测产能全面吃紧，涨价与扩产共振，设备、零部件、材料的订单能见度持续拉长。

**（资料来源：IT 之家，财联社，集微网，观察者网，科创板日报，新浪财经）**



仅供内部参考，请勿外传！



# 新闻及公司动态

## 行业新闻

**图表 1.芯片及服务器-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 22 日 | 海光信息算力芯片 CPU 1000 系列正式发布，该产品是面向低功耗、嵌入式和端侧算力需求，采用 C86 架构打造的轻量级 CPU。海光信息总裁沙超群表示，1000 系列是海光首款面向端侧智能的算力芯片，标志着公司的算力版图从云侧延伸到边缘和端侧；1000 系列并非单一芯片，而是一个面向端侧算力的产品系列，将根据不同场景需求调配 CPU、GPU、NPU 算力，持续丰富嵌入式产品矩阵。 | 财联社 |
| 9 月 22 日 | 2026 杭州云栖大会上，平头哥发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，性能是真武 M890 的三倍，这是目前算力性能领先的中国自研 AI 芯片，可满足万亿级参数大模型的训练和推理需求。该芯片将于 2027 年第一季度量产售卖。 | 中国科学报 |
| 9 月 22 日 | AI 基础设施缺货潮正从 GPU、HBM 蔓延至服务器 CPU。英特尔与 AMD 正与中国服务器客户签订更长期采购协议，主要锁定采购数量而非价格，部分产品今年以来涨幅已超过 40%，个别型号更以每月逾 10%的速度攀升。 | 快科技 |
| 9 月 22 日 | 三星计划 2027 年将 HBM4 及 HBM4E 的出货量提高一倍甚至更多。为配合扩产，三星将关键材料玻璃载板的采购量提升至今年的 2.5 倍，每月数量从 2 万片增加至 5 万片。三星此次扩产主要集中在 12 层及以上堆叠的产品上，产品结构也将发生根本性变化。HBM4 系列（含 HBM4 及 HBM4E）在整个 HBM 产品线中的比重将从今年的 40%大幅提升至明年的 80%。HBM4E 产能也将逐步爬坡。 | 快科技 |

*资料来源：中银证券*

**图表 2.云计算-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 22 日 | 2026 云栖大会上，阿里云 CTO 李飞飞系统性阐述了 Agentic Cloud 战略布局，阿里云将 Model、Harness、Context 作为核心构建场景，推出全新的云上算力底座和 Agent 构建治理平台 AgentCore、Agent Sandbox、新一代高性能存储 CPFS 等一系列新品，助力 AI 进入生产流程、走向规模化价值创造。 | 新华网 |
| 9 月 25 日 | 阿里云在云栖大会上宣布新一轮全球基础设施扩建计划：未来 12 个月，将于土耳其、芬兰和荷兰首次设立云计算地域节点，并扩建马来西亚、德国、阿联酋、法国和中国香港的数据中心。在国内算力供给方面，阿里云进一步扩大云上超节点算力服务范围。继乌兰察布首批开展后，今年第四季度将在宁夏中卫地域新增灵骏真武 M890 超节点服务。 | 财联社 |

*资料来源：中银证券*

**图表 3.人工智能-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 22 日 | 小米正式发布并开源全新一代 MiMo 大模型：全模态旗舰模型 Xiaomi MiMo-V2.6-Pro 、高效推理模型 Xiaomi MiMo-V2.6-Flash，并同步上线 MiMo-V2.6-Pro 的超高速模式 V2.6-Pro-Ultraspeed，以及 MiMo Desktop 桌面客户端正式版。 | 人民财讯 |
| 9 月 25 日 | 2026 云栖大会现场，阿里云旗下 AI 智能体电脑 QwenBook 首次亮相。这是一款能自主理解用户意图并不断进化的 AI 智能体电脑，搭载 Skill 键盘阵列、全局 AI 按键、语音手写笔等交互入口。QwenBook 还宣布与开源项目 Omarchy 展开合作，探索面向 Agent 的新一代桌面操作系统。目前，QwenBook 已与高通、英特尔、罗技、绿联等生态伙伴完成适配，并打通支付宝、千问输入法等阿里系核心应用。此外，千问办公发布 AI Agent 硬件产品 QwenNote，并推出首个 QwenNote 产品 A2。 | 科创板日报 |
| 9 月 25 日 | 工业和信息化部近日出台《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，中国信息通信研究院副院长王志勤认为，从开发方式看，人工智能推动软件产业全要素生产率实现系统性跃升，“人机协同”成为新型生产模式，软件生产从“手工编码”迈向“工业化智能生产”。 从服务模式看，人工智能推动软件服务由“产品交付”向“结果交付”、由“按功能付费”向“按价值付费”转型，场景化服务能力成为打通人工智能应用“最后一公里”的关键。 | 中国新闻网 |

*资料来源：中银证券*

仅供内部参考，请勿外传！



**图表 4.数字经济-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 21 日 | 我国首批数据产权登记凭证陆续发放。56 家企业和机构拿到相关数据有效证明。首批获发数据产权登记凭证的主体包括国有企业、事业单位和民营企业，涵盖医疗、交通、科研等 10 余个行业领域。 | 新华社 |
| 9 月 21 日 | 国家数据局在江苏苏州组织召开国家数字经济创新发展试验区建设现场会，总结试验区建设进展情况，交流典型经验，部署下阶段重点工作。会议指出，各试验区顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快试验区建设任务推进，在数据要素市场化配置改革、数字基础设施建设、数字产业集群培育、数据赋能重大场景应用拓展、数据领域对外合作等重点领域取得显著成效，探索构建促进数字经济发展的体制机制，形成一批数据要素价值释放新路径，加快构建现代化产业体系，全方位赋能经济高质量发展。 | 苏州市数据局 |

*资料来源：中银证券*

**图表 5.网络安全-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 21 日 | 20 多个国家和区域领导人发联合声明，警示前沿人工智能的发展速度可能超过人类的管控能力，呼吁各方采取具约束力的安全措施。声明的签署国包括新加坡、挪威、芬兰、澳大利亚、加拿大、德国、西班牙、爱尔兰、荷兰、南非和肯尼亚，以及欧盟委员会主席冯德莱恩等。 | 联合早报 |

*资料来源：中银证券*

**图表 6.工业互联网-行业动态**

| 公布时间 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|
| 9 月 24 日 | 近日，中国工业互联网研究院智能化研究所联合北京信息化和工业化融合服务联盟、中国科学院计算技术研究所共同发布《工业智能体发展报告》。 | 中国工业互联网研究院 |

*资料来源：中银证券*

## 公司动态

**【光环新网】**公司对和林格尔智算中心项目追加投资不超过人民币 12.65 亿元，追加投资后该项目总投资金额约为人民币 25.00 亿元。调整后，和林格尔智算中心项目规划建设 2 栋算力中心及 2 栋动力中心，1 栋 110kV 变电站，1 栋运维配套楼等建筑工程以及 2 栋算力中心相应机电工程，总建筑面积约 12.12 万平方米。园区变电站主变配置为 63MVA*4（3 用 1 备），设计 PUE＜1.2，可部署 7,000-10,000 个 2N 12-16KW 标准机柜，项目建成后总产能约 90-120MW，可匹配高功率液冷机柜，计划投资总额约人民币 25.00 亿元，资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等，其中银行贷款占比不超过 70%。

**【麦格米特】公司**拟以自有资金人民币 66,364.48 万元现金收购公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司 46.30%的股权。本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为 2026-2028 年，业绩承诺期内深圳焊接的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计不低于 4.05 亿元。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。

**【长芯博创】**公司发布 2026 年限制性股票激励计划（草案），拟授予激励对象的限制性股票数量为 300.00 万股，约占 2026 年 9 月 21 日公司股本总额 29,483.3753 万股的 1.02%。本次授予为一次性授予，无预留权益。授予价格为每股 160 元。

**【源杰科技】**ZHANG XINGANG 先生、秦燕生先生、秦卫星先生、张欣颖女士因自身资金需求，计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，合计减持公司股份数量不超过 288,500 股，即不超过公司总股本的 0.2317%。

**【澜起科技】**近日，公司收到 WLT 出具的《减持股份计划的告知函》，因其有限合伙人股权激励行权资金需要，WLT 拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 2,330,000 股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过 0.19%。本减持计划拟自 2026 年 11 月 2 日起的 3 个月内进行，减持价格将根据市场价格确定。

仅供内部参考，请勿外传！



**【仕佳光子】公司**于 2026 年 9 月 21 日收到上海证券交易所出具的《关于受理河南仕佳光子科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕218 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

**【光迅科技】**公司控股股东烽火科技集团有限公司将其持有的公司 291,478,944 股股份无偿划转至芯珂（武汉）技术有限公司持有。本次无偿划转完成后，公司控股股东变更为芯珂技术。公司实际控制人不变，仍为中国信息通信科技集团有限公司。

**资料来源：公司公告**

仅供内部参考，请勿外传！



## 风险提示

CSP 厂商资本开支落地不及预期。

FDE 交付成本较高、标准化和规模化能力不足。

B 端 AI 需求不及预期。

仅供内部参考，请勿外传！



## 披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

## 评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

**公司投资评级：**

买　　入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；

增　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；

中　　性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

**行业投资评级：**

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；

中　　性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

仅供内部参考，请勿外传！

## 风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

**中银国际证券股份有限公司**
中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

**相关关联机构：**

**中银国际证券有限公司**
香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话:(852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真:(852) 2147 9513

**中银国际控股有限公司北京代表处**
中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编:100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

**中银国际(英国)有限公司**
2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

**中银国际(美国)有限公司**
美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

**中银国际(新加坡)有限公司**
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371